

**BZ17-147****半導体ウェーハー（Si, SiC etc）の裁断、研磨パートナー**提案提出期限

- 2017年10月31日

依頼企業の概要

- **JFE 商事エレクトロニクス株式会社**
- <<http://www.jfe-shoji-ele.co.jp/>>
- 半導体および同周辺機器の販売・商品企画等
- 電子部品の実装・組立・検査等の装置および周辺機器等の販売・据付・保守等
- JFE 商事エレクトロニクス株式会社は、JFE グループにおける唯一のエレクトロニクス商社として、時代の先を見据え、技術サポート力とシステム提案力を備えたお客様のパートナーとして、半導体デバイスから各種エレクトロニクス機器等、特徴ある豊富なプロダクトの取扱いは勿論、これらを活用したソリューション&サポートの提供を続けてまいります。

提案者にとっての機会（協業形態）

中小企業・大学との想定される協業の形態を下記から選択ください（複数選択可）

	部材供給
<input type="radio"/>	受託加工
	技術ライセンス
<input type="radio"/>	受託開発
	その他（                      ）

求める技術とその背景

- JFE グループの独自技術である高熱伝導・低熱膨張のCr-Cu 複合材（主にヒートシンク・スプレッダー用途）を使った、半導体市場向けの素材供給を模索しております。
- その際、当社の材料と半導体ウェーハーを組み合わせることで提案することとなり、半導体ウェーハーの高平坦度研磨、ダイシング、金属蒸着膜形成、ベベリングなどの半導体ウェーハー加工技術を有するパートナー企業を求めています。

想定している用途

- 電子部品向けヒートシンク
- パワー・LED 半導体用基盤

想定されるビジネス規模

- 開始当初は試作などの小ボリュームからスタートする予定です。
- スペックインが完了次第、量産に入りますが具体的なボリュームは現時点では不明です。

開発スケジュール

- 素材自体の開発は完了しております。
- 2017年 スペックイン
- 2018年 量産開始予定

**現時点で求める技術の完成度**

- すでに半導体ウェーハの加工実績をお持ちである企業様が望ましいです。

**対象とするアプローチ例**（下記に限らない）

- Mo-Cu、W-Cu の代替え材料の提案によるコストダウン。
- 顧客スペックインを行う際に、顧客要望に応じたウェーハ材料との組み合わせが必要となるため、様々な半導体ウェーハ材料の加工に強みを持つパートナー企業とともに、市場提案を推進し、スペックインを目指す。

**BIZ SAITAMA** の概要、提案方法はこちらの URL をご覧ください  
[http://biz-saitama.jp/exhibition\\_entry.html](http://biz-saitama.jp/exhibition_entry.html)

**【事務局】**

- BIZ SAITAMA 実行委員会事務局：さいたま市産業創造財団  
<http://www.sozo-saitama.or.jp/>
- 商談会に関するサポート：株式会社ナインシグマ・ジャパン  
<http://www.ninesigma.co.jp/>

**【問い合わせ窓口】**

- メール：[biz-sai9@sozo-saitama.or.jp](mailto:biz-sai9@sozo-saitama.or.jp)
- 電話：03-3219-2006（ナインシグマ・ジャパン：BIZ SAITAMA 担当宛）